



料金別納  
郵便

# BUSINESS REPORT JEM TODAY

2008年度 第3四半期のご報告  
2008年4月1日から2008年12月31日まで

**JEM** 日本電子材料株式会社 証券コード:6855

〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町二丁目5番13号  
<http://www.jem-net.co.jp>

POST CARD

第3四半期の情報は、中面をご覧ください。

## TOP MESSAGE

### ご挨拶

株主の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。2008年度第3四半期を終了しましたので、事業の概況をご報告いたします。

当第3四半期は、急激な経済環境悪化に伴う未曾有の半導体不況により、当社業績も大変厳しい状況で推移しました。このような状況に対処すべく、徹底的な経費削減、役員報酬削減、海外拠点の閉鎖など可能な限りの業績改善に向けた施策を実施して参りましたが、事業環境の悪化は想定をはるかに凌ぐスピードで進行しております。

このため、抜本的な経営体質の強化策が必要不可欠と判断し、工場集約などの国内外の拠点再編に加え、当社創業以来初めてとなる正社員の希望退職者募集を行わざるを得ませんでした。

来年度も厳しい事業環境が継続することは間違いありません。当社といたしましては、生き残りをかけ更なる追加施策を実施し、当面を生き抜くと共に、市況好転時の飛躍への備えに万全を期して参ります。中でも、予てより進めております戦略製品「Mタイプ」の事業化の早期実現に全力で取り組む所存であります。

今後とも皆様の暖かいご支援よろしく願っています。

代表取締役社長 坂根英生

## TOPICS

### 経営体質強化に向けた取り組み

サブプライムローン問題に端を発する金融危機は、实体经济にも急激かつ大きな影響を及ぼし、当社の主たる事業分野である半導体業界も多大な影響を受けています。

当社でも徹底的な経費削減をはじめ、役員報酬の削減、JEMシンガポールの閉鎖など可能な限りの施策を進めてまいりましたが、本年度だけでなく来年度も厳しい状況が継続することが予想されます。このため、収益性の改善を図ることが急務であると判断し、経営体質強化に向けた諸施策を実施することとしました。なお、諸施策実施に伴う費用は業績予想の修正に織り込んでいます。

#### ●主な施策

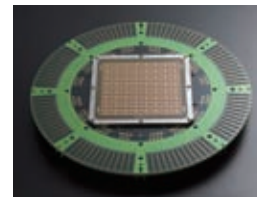
- ・国内拠点の再編………プローブカードの製造を熊本工場に集約
- ・海外拠点の再編………JEM香港(深圳工場)の製造能力増強  
JEM台湾・ベトナム協力工場を縮小
- ・拠点再編と共に全社的な人員最適化に向け、希望退職者募集

### Mタイプ事業化の近況

MEMS技術を用いた次世代型プローブカード「Mタイプ」。

現在開発中の「MCシリーズ」は、市場規模の大きいメモリーIC向けの製品であり、中長期的な当社の成長を担う上で重要な製品です。MCシリーズにつきましては、メモリーICの生産に多く使用されている300mmウエハー一括タイプのサンプル出荷を行いました。

今後も、量産化に向けた課題を着実にクリアして、早期市場投入を目指します。



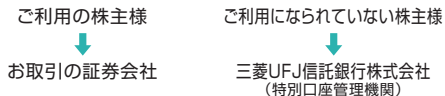
## JEM TODAYは年4回発行 最新情報をお届けします

JEM TODAYは毎年4回、四半期ごとに発行しています。  
 通期報告・第1四半期報告は3月末現在の株主様へ、第2四半期  
 報告・第3四半期報告は9月末現在の株主様へお送りしています。

### 株式関係のお手続きについて

株券電子化の実施に伴い、株式関係のお手続きに関しましては、  
 株主様の株式所有状況によって異なりますのでご注意ください。

#### 証券会社経由で証券保管振替機構(ほふり)を



なお、株式事務に関する一般的なお問合せ、支払期間経過後の  
 配当金に関するご照会などは当社株主名簿管理人、特別口座  
 管理機関の三菱UFJ信託銀行にお問合せ下さい。

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社  
 特別口座管理機関 大阪証券代行部  
 〒530-0004 大阪市北区堂島浜一丁目1番5号  
**☎0120-094-777**  
 ホームページ <http://www.tr.mufj.jp/daikou/>

● 株券電子化に関するご質問・ご相談は株券電子化コールセンターへ ●  
 お問合せ先 「株券電子化」なんでも相談窓口(株券電子化コールセンター)\*

**☎0120-77-0915**

\*株券電子化コールセンターは、株式会社証券保管振替機構・日本証券業協会・  
 株式会社証券取引所が共同で運営する株券電子化についての相談窓口です。



## 2008年度 第3四半期のご報告

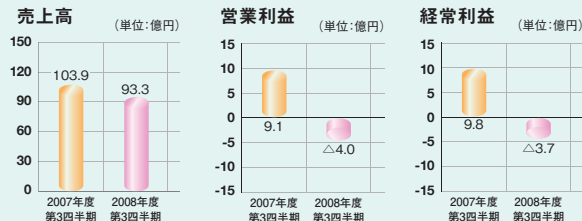
### 事業環境

当社グループの主たる事業分野である半導体市場は金融危機に伴う世界  
 経済の減速に伴い、急速に事業環境が悪化しました。  
 ロジックIC市場では携帯電話やデジタル家電などの需要低迷が深刻化  
 し、半導体デバイス需要の低迷が続きました。また、メモリーIC市場でも  
 半導体デバイスの価格下落に加え、最終製品の販売不振に伴い半導  
 体デバイス需要が減少するなど、ロジックIC市場、メモリーIC市場ともに  
 更に厳しい市場環境となりました。

### 売上高・収益動向

当社グループの売上につきましては、既存製品の拡販により売上確保  
 に努めましたが、急速な事業環境悪化の影響は大きく、ロジックIC向け  
 の売上低迷に加え、数量需要が比較的堅調であったメモリーIC向けに  
 つきましても売上が減少するなど厳しい状況となりました。  
 また、利益面につきましても経費の削減や原価低減等に取り組んできま  
 したが、メモリーIC向けの価格競争の継続に加え、売上減少の影響が大  
 きく厳しい状況となりました。  
 以上の結果、当第3四半期累計の売上高は93億3千1百万円、営業損  
 失4億7百万円、経常損失は3億7千1百万円、四半期純損失は2億3  
 千8百万円となりました。

### 業績の概況(連結累計)



### 業績予想

2009年2月4日に通期業績予想を修正いたしました。

### 2008年度通期業績予想の修正(2008年4月1日～2009年3月31日)

(連結)

単位:百万円

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
前回発表予想	12,800	△240	△200	△140
今回修正予想	10,700	△1,070	△1,170	△1,100

(個別)

単位:百万円

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
前回発表予想	11,700	△480	△260	△100
今回修正予想	9,600	△1,230	△1,020	△770

### 業績予想の修正理由

金融危機を発端とした世界同時不況により、半導体業界の経営環境も急  
 速に悪化しています。  
 当社におきましても最終製品の販売不振に伴う半導体需要の減少や設備  
 投資抑制の影響を受け、厳しい事業環境の継続が予想されるため通期の  
 業績予想を修正いたしました。

### 期末配当について

急激な経営環境の変化により先行きが非常に不透明であるため、現時点  
 では当期の期末配当金につきましては未定とし、当期実績と来年度の業  
 績見通しを勘案した上で改めてご提案させていただきます。